

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-005

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 源峰私募基金：李宇恪；光大富尊：罗杨；粤科资本：徐安生、沈潇健；海珠数字经济创投：刘鑫、孟皓；湖南高新创投：刘敏杰、贾幻；湖南轻盐创投：李宗效、刘泽雨；华夏银行：马睿、惠倩颖；建投华科：陈伊荻；瑞华投资：章礼英；南昌产投：罗浩良、匡雯；农银国际：杨勇；青岛国信：孙帆、苑博、吕远；陕西新时代资本：李鹏；尚融资本：梁雅雯、谢兴；深圳鼎锋明道资产：孙泉；苏州安亚：倪文超；苏州高新创投：朱敏、徐宇鑫；元禾重元：傅履谦；台州城投沣收一号：李亚雄、顾定峰；无锡市创投：张倩；信达资本：万毅；兖矿资本：李素素；粤开证券：周越；粤开资本：李勇杰；泽安私募：张林凤；鼎钧投资：别道文；正大天晴：彭岩；中移资本：王翔、兰巍；云南惠众：季文南；上海虢盛：谷茹、蔡洁；国泰海通：雷婕；鼎锋明道：陈正旭；常州金融投资：陈光宇；财通基金：张洲铭 |
| 时间 | 2026年6月9日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 蒋澍 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司概况</p> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> |

公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26% 股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年第一季度分别实现营收 222.69 亿元、238.82 亿元、279.21 亿元和 74.82 亿元。公司 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年第一季度的归母净利润分别为 1.69 亿元、6.78 亿元、12.19 亿元和 3.29 亿元。

二、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+ 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：请问本次向特定对象发行股票审核到什么程度了？

回复：公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 6 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

问题 3：本次发行的发行数量是多少？

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 455,279,073 股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 151,759,691 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 151,759,691 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

问题 4：本次发行的发行时间是什么时候？

回复：公司本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

问题 5：公司本次发行有哪些募投项目？

回复：公司基于对半导体产业趋势的洞察与自身产能版图的评估，持续提升和优化自身封测产能，选择具备战略价值、市场前景度高、符合技术演进方向、确定性强的项目作为资本投入及产能升级的主轴，为境内外客户提供专业可靠的封测解决方案，巩固公司在产业链中的核心支撑作用。具体项目如下：

1. 存储芯片封测产能提升项目：本项目计划投资 88,837.47 万元提升存储芯片封测产能，项目建成后年新增存储芯片封测产能 84.96 万片。本项目实施将有助于公司进一步扩大生产规模、优化产品结构、增强抗风险能力，巩固并增强公司在存储封测领域的优势地位。

2. 汽车等新兴应用领域封测产能提升项目：本项目计划投资

109,955.80 万元提升汽车等新兴应用领域封测产能,项目建成后年新增汽车等新兴应用领域封测产能 50,400 万块。本项目实施将有助于公司进一步调整产品结构、扩大生产规模、增强抗风险能力,巩固并增强公司在车载等封测领域的优势地位。

3. 晶圆级封测产能提升项目:本项目计划投资 74,330.26 万元提升晶圆级封测等产能,新增晶圆级封测产能 31.20 万片,同时亦提升该厂区高可靠性车载品封测产能 15.732 亿块。本项目实施将有助于公司扩大晶圆级封装等先进封装实力,促进公司向下游客户提供完整解决方案,优化产品结构,进一步增强公司在行业中的竞争力及影响力。

4. 高性能计算及通信领域封测产能提升项目:本项目计划投资 72,430.77 万元用于提升高性能计算及通信领域封测产能,项目建成后年新增相关封测产能合计 48,000 万块。本项目有助于公司优化产品结构,提升公司的经营规模及盈利能力,进一步巩固在先进封测领域的优势。

5. 补充流动资金及偿还银行贷款:公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况,拟使用募集资金中的 105,000.00 万元补充流动资金及偿还银行贷款。

问题 6:请简单分析一下本次募投项目“高性能计算及通信领域封测产能提升项目”的必要性。

回复:高性能计算及通信领域封测产能提升项目主要涉及倒装封装(Flip Chip)与系统级封装(System-in-Package, SiP)等先进封装技术。随着下游芯片应用场景不断向高性能、高集成、高带宽方向演进,传统封装形式在互连密度、散热能力、系统集成效率等方面已难以满足新一代芯片在算力密度、电气性能与封装尺寸等方面的综合需求。倒装与系统级封装作为当前主流的先进封装架构,已成为支撑人工智能、高性能计算、5G 通信、边缘计算、移动终端和车载智能化等前沿应用的重要技术路径。

具体而言,倒装封装通过芯片正面朝下与基板直接互联,省去传统引线键合结构,显著缩短信号传输路径、降低寄生电感与串扰,提高信号完整性与传输速率,同时支持更高 I/O 数量及更大封装面积,具备优良的热性能与电气性能,特别适用于高算力、高频、高速芯片的封装需求,广泛应用于 AI 加速芯片、CPU、GPU、

| | |
|----------|--|
| | <p>网络通信芯片、主控 SoC 芯片等产品。</p> <p>系统级封装则面向下游芯片“小型化+多功能集成”的需求趋势，通过在同一封装体内集成多颗芯片或有源/无源器件，形成功能完整、体积紧凑的微系统封装单元，可在有限空间内实现复杂信号处理、射频收发、存储、功率等多功能协同工作，显著提升系统集成度与终端产品的性能稳定性。 SiP 广泛应用于通信领域，如射频芯片等，涉及移动智能终端、可穿戴设备、物联网设备等典型终端场景，特别是在 5G 等无线通信技术推进下，其结构优势与市场渗透率持续提升。</p> <p>基于上述技术趋势及市场需求情况，公司拟通过本募投项目进一步扩展倒装及系统级封装的产能布局，完善面向高性能、高密度、多集成应用场景的先进封装体系，提升对下游市场产品升级转型的支撑能力。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2026 年 6 月 9 日 |